

| 適用規格 | | | | | |
|--|----------------|--|---|-------------------------|----------|
| 定 格 | 使用温度範囲 | -35℃ ~ +85℃ (注1) | 保存温度範囲 | -10℃ ~ +60℃ (注3) | |
| | 使用湿度範囲 | 40% ~ 80% (注2) | 保存湿度範囲 | 40% ~ 70% (注3) | |
| | 電 圧 | 100V AC(DC) | 適合コネクタ | DF19(G)*S-1# (注4) | |
| | 電 流 | AWG28 : 1 A AWG30 : 0.9 A AWG32 : 0.8 A | | | |
| 性 能 | | | | | |
| | 項 目 | 試 験 方 法 | 規 格 | QT | AT |
| 構 造 | 外觀, 構造及び仕上げ | 目視, 寸法測定器にて測定する。 | 図面と合致していること。 | ○ | ○ |
| | 表 示 | 目視にて確認する。 | | ○ | ○ |
| 電 氣 的 性 能 | 低電圧, 低電流下の接触抵抗 | 20 mV 以下, 1 mA (DC又は 1000 Hz) で測定する。 | 30 mΩ以下 | ○ | - |
| | 絶 縁 抵 抗 | DC 100 Vで測定する。 | 500 MΩ以上 | ○ | - |
| 機 械 的 性 能 | 耐 電 圧 | AC 300 Vの電圧を 1 分間印加する。 | せん絡・絶縁破壊がないこと。 | ○ | - |
| | 繰り返し動作 | 30 回の抜き差しを行う。 | ① 接触抵抗: 30 mΩ以下 ② 破損, ひび, 部品のゆるみがないこと。 | ○ | - |
| 耐 振 性 | 耐 衝 撃 性 | 周波数 10 ~ 55 Hz, 片振幅 0.75 mm, 3 方向 各 2 時間試験する。 | ① 1 μs以上の電氣的瞬断がないこと。 ② 破損, ひび, 部品のゆるみがないこと。 | ○ | - |
| | | 加速度 490 m/s ² , 持続時間 11 ms, 正弦半波 3 方向 各 3 回試験する。 | | ○ | - |
| 環 境 的 性 能 | 定常状態の耐湿性 | 温度 40±2 °C, 湿度 90 ~ 95 %中に 96 時間放置する。 | ① 接触抵抗: 30 mΩ以下 ② 絶縁抵抗: 500 MΩ以上 ③ 破損, ひび, 部品のゆるみがないこと。 | ○ | - |
| | 温度サイクル | 温度 -55 → +5~35 → +85 → +5~35 °C 時間 30 → 2~3 → 30 → 2~3 分 を 5 サイクル試験する。 | | | |
| | 半田耐熱性 | 【リフローの場合】 《リフロー部》 MAX 250℃ 10秒以内 230℃以上 60秒以内 《予熱部》 170~190℃ 60~120秒 リフロー炉に2回通し, 常温常湿中に 1時間放置後, 測定する。 【手半田の場合】 半田ごてで350±5°C, 5±1秒の条件にて半田付けを行う。但し端子に力を加えないこと。 | | 外觀の変形及び端子などの著しいガタがないこと。 | ○ |
| | 半田付け性 | 半田温度 245 °C, 浸せき時間 5 秒間の半田付けを行う。 | 半田浸せき面の95%以上が新しい半田でぬれていること。 | ○ | - |
| 備考 (注1) 通電による温度上昇を含む。 (注2) 結露のないこと。 (注3) 基板搭載前の未使用品に対する長期保存状態に適用。 基板搭載後, 輸送時の一時保管は使用温湿度範囲を適用。 (注4) # = 結線形態記号 (C: 圧着ソケット, F: FPCソケット, SD: 細線同軸ソケット) | | | | | |
| | △の数 | 訂正記事 | 設計 | 検図 | 年月日 |
| △ | | | | | |
| 試験規格の記載のない試験方法は JIS C 5402を適用している。 | | | 承認 | TS. SAKATA | 09.03.02 |
| | | | 検 図 | TS. KUMAZAWA | 09.03.02 |
| | | | 担 当 | SN. KOBAYASHI | 09.02.27 |
| | | | 製 図 | SN. KOBAYASHI | 09.02.27 |
| 注 QT: 確認試験 AT: 製品検査 ○: 適用項目 | | | 図番 | SLC4-311646-04 | |
| HRS | 製品規格表 | | 製品名 | DF19G-*P-1H(54) | |
| | ヒロセ電機株式会社 | | 製品コード | CL685- | △ 1/1 |